

The EMC logo is located in the top left corner of the image. It consists of the letters 'EMC' in a bold, teal, sans-serif font. The background of the top half of the slide features a large, glowing digital graphic of a human head profile, composed of blue and orange particles and connected by a network of white lines. To the right of this graphic, four people (three women and one man) are standing and looking at the display. A teal and white curved graphic element is on the left side of the slide.

EMC

台光電子材料股份有限公司

全球環保基材的領航者

法人說明會簡報
110年3月

免責聲明

本簡報之內容可能包括本公司基於從各項來源所取得的資訊，對於營運、財務狀況與企業發展情形的前瞻性預估。

因為包括但不限於市場需求、價格波動、競爭態勢、供應鏈變動、全球經濟局勢、匯率波動及其他本公司無控制力之風險等各種因素，實際的營運、財務狀況與企業發展情形，可能會與本公司於預測中明示或默示敘述有差異。

本簡報之內容若有對未來之前瞻性預估，僅反映本公司於發佈當時之看法。本公司並無義務於日後情況變更時，更新前瞻預估。

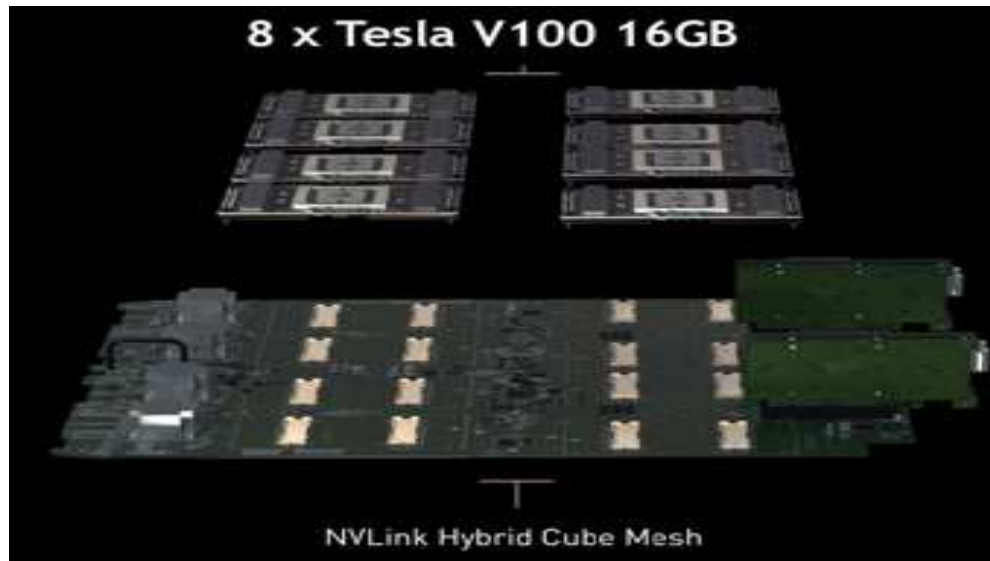
簡報大綱

- 銅箔基板產業展望
- 公司長期財務績效
- 附註

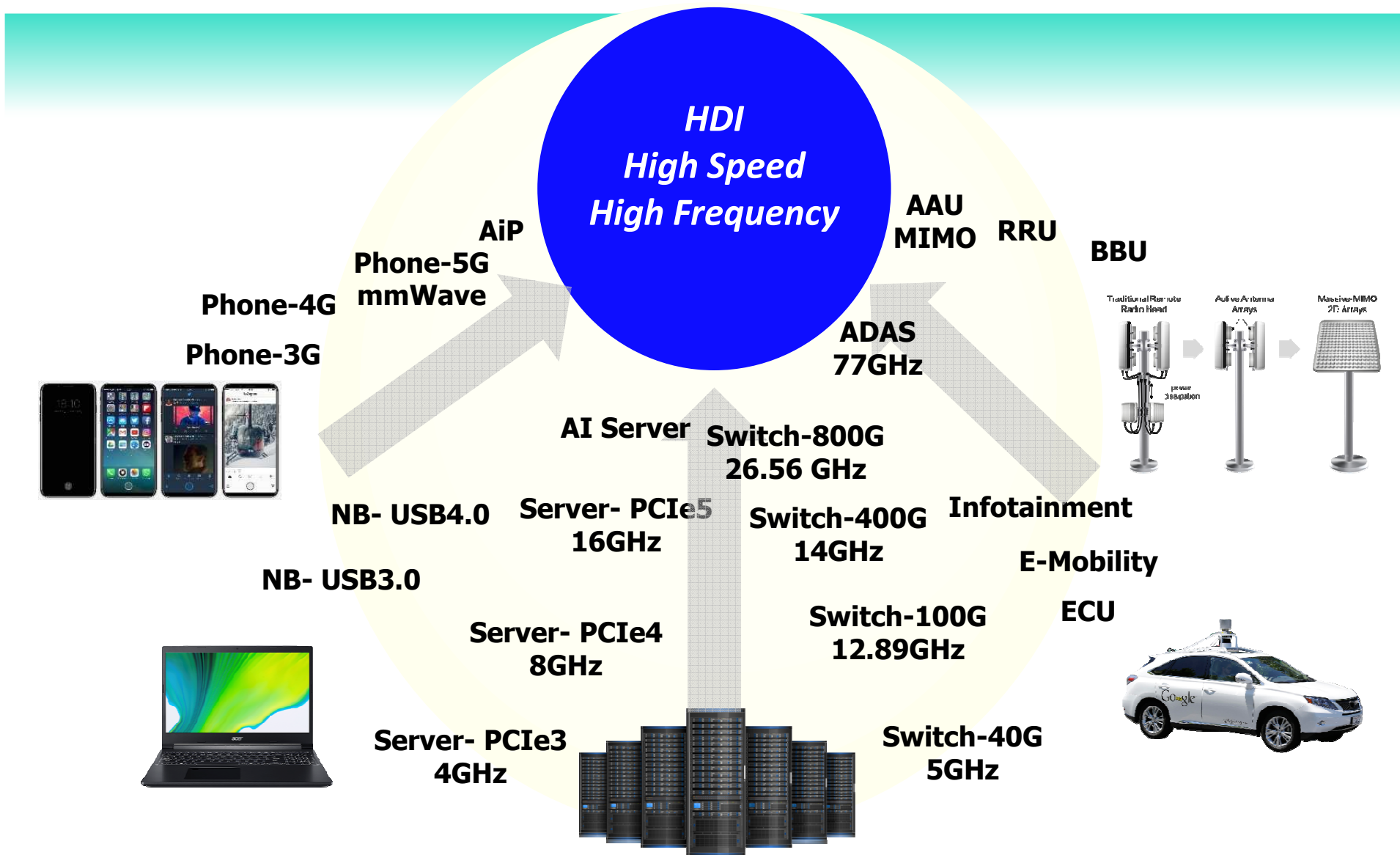
網通板設計趨勢朝向細線路高密度互連技術發展

- **趨勢一：無鹵素環保基材**—已成為網通業者偏好或指定的材料
PCIe4的網通產品，例如但非僅限於Intel開發的Whitely伺服器平台，皆要求必須採用無鹵素基材。
- **趨勢二：高密度互連技術**—AI 晶片、GPU及CPU，以及半導體的異質整合技術，皆使接腳數目呈幾何級數增加
縮小線寬線距，已成為PCB業者普遍採用的設計趨勢。
- **趨勢三：高密度互連技術的工藝**成為高階網通板的必須製造技術。
- **台光在無鹵素及高密度互連技術多年來累積的經驗及知識，已成為同業望塵莫及的競爭優勢。**

多組GPU成為超高速運算AI Server

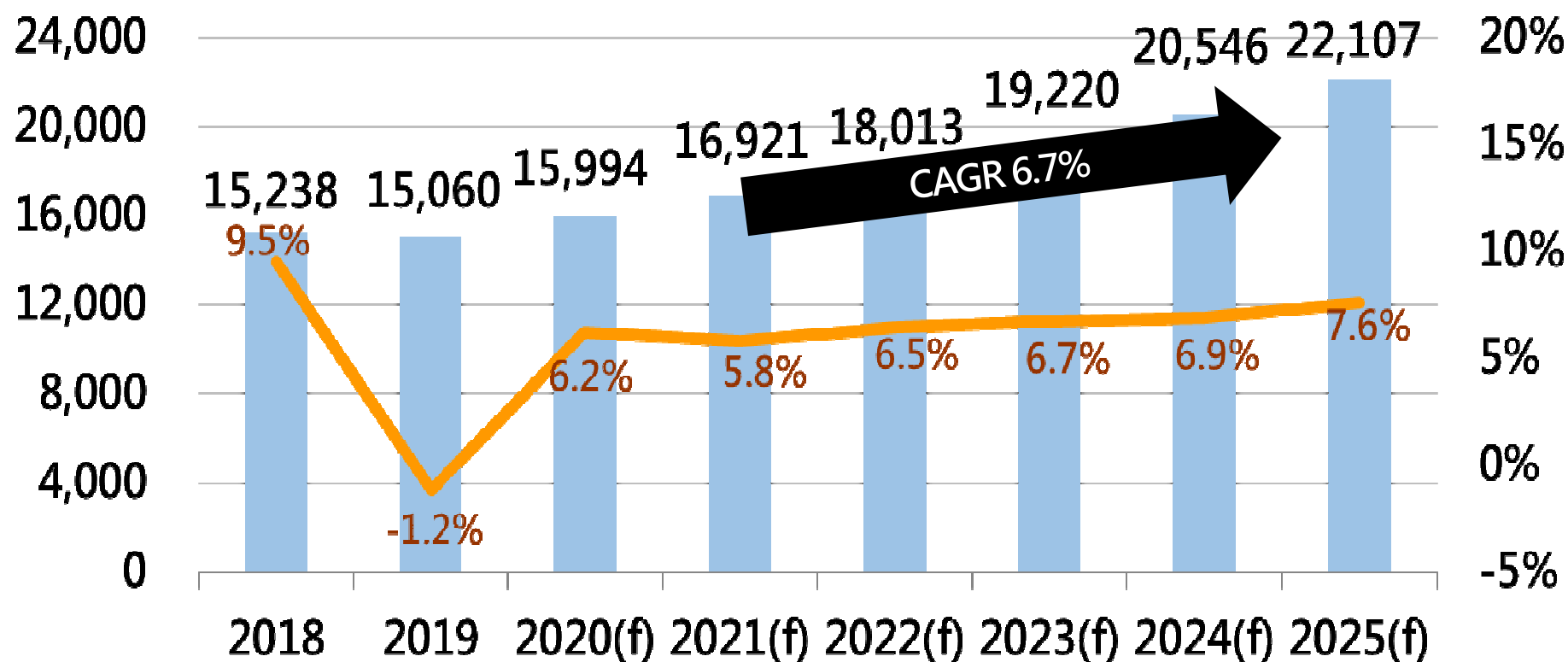


5G基礎建設材料的發展趨勢: 高密度連結, 高速, 高頻



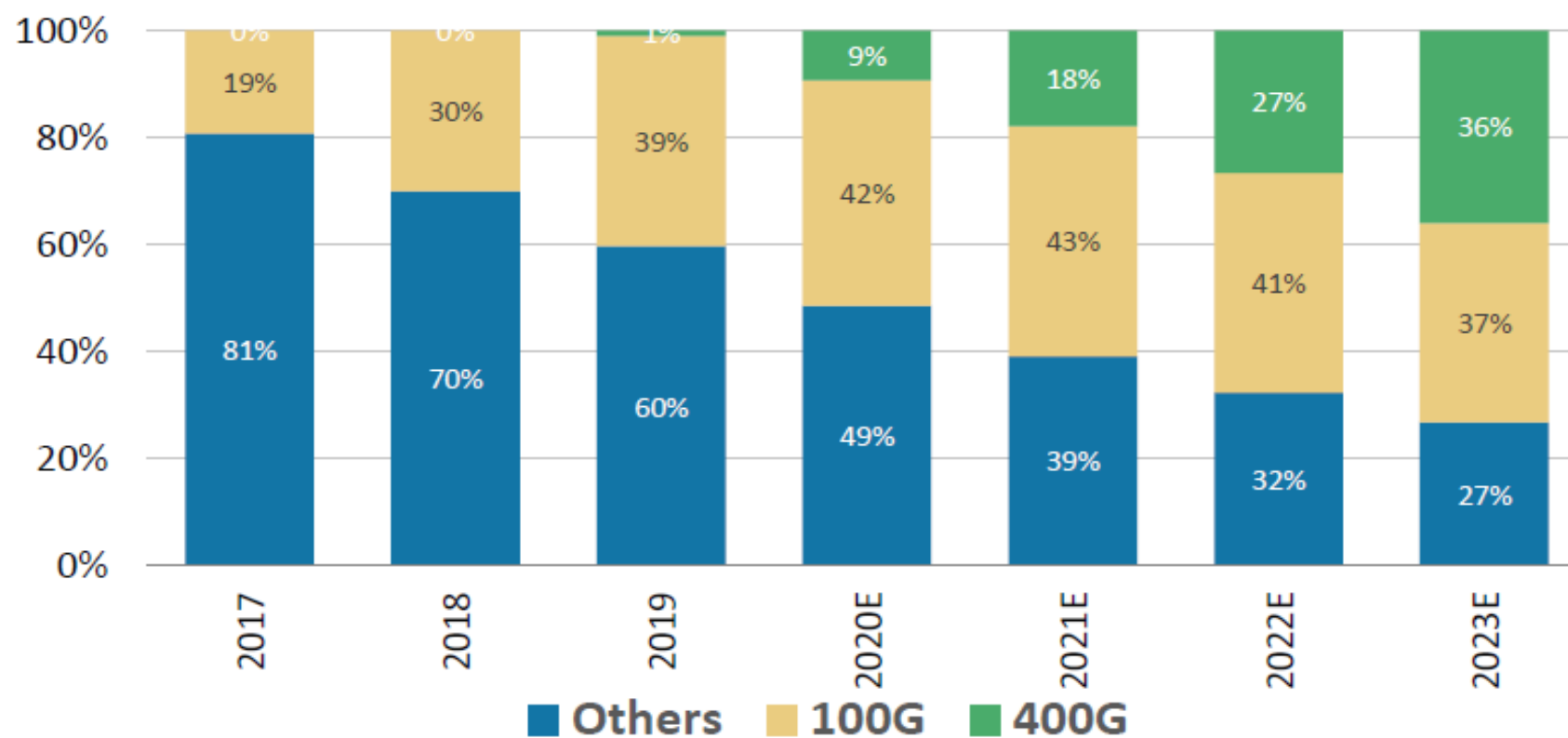
伺服器末年五年的複合成長率達 6.7%

Unit : k set



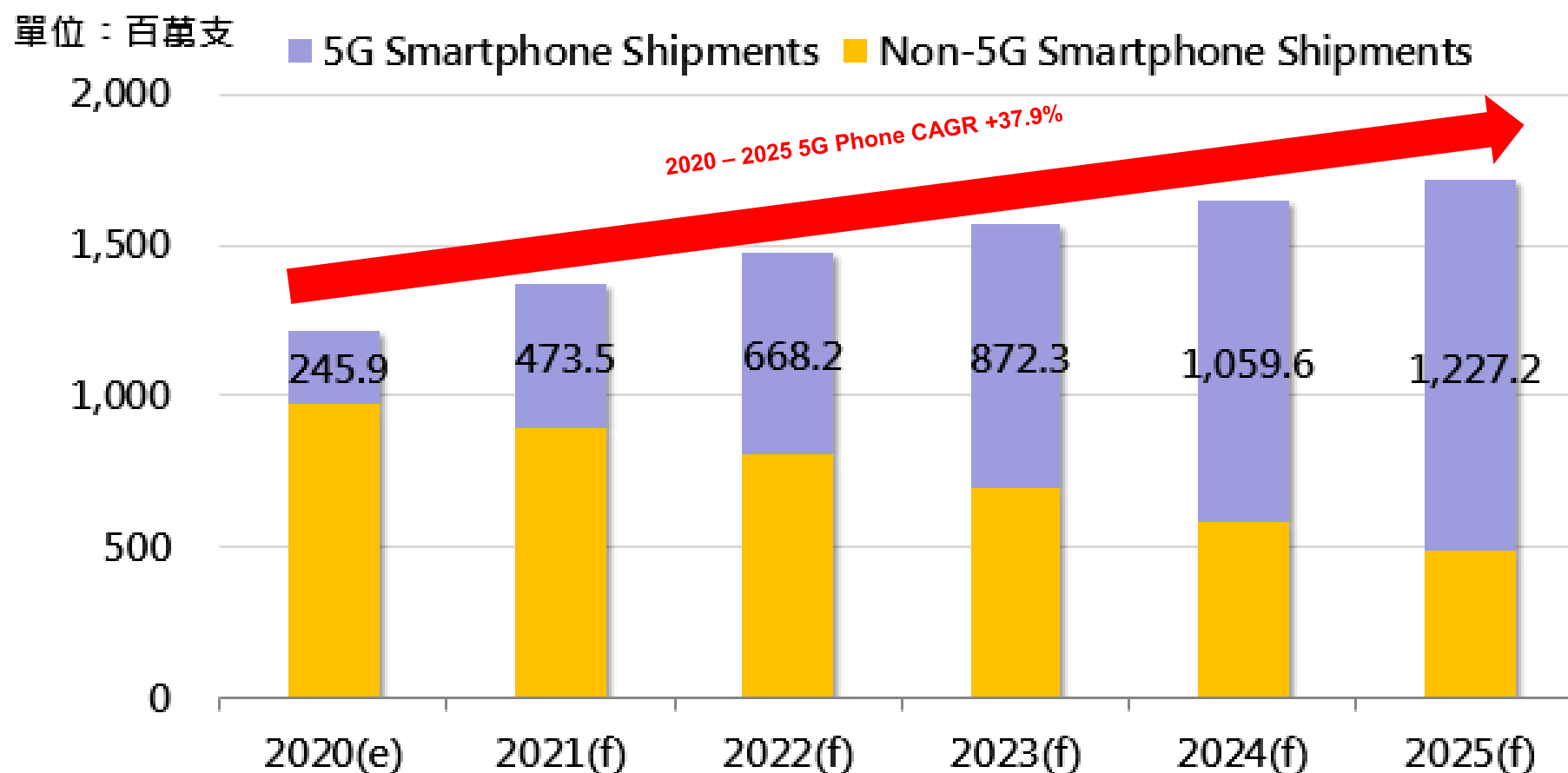
100/400G 交換器將成為主流

2017~2023 switch split



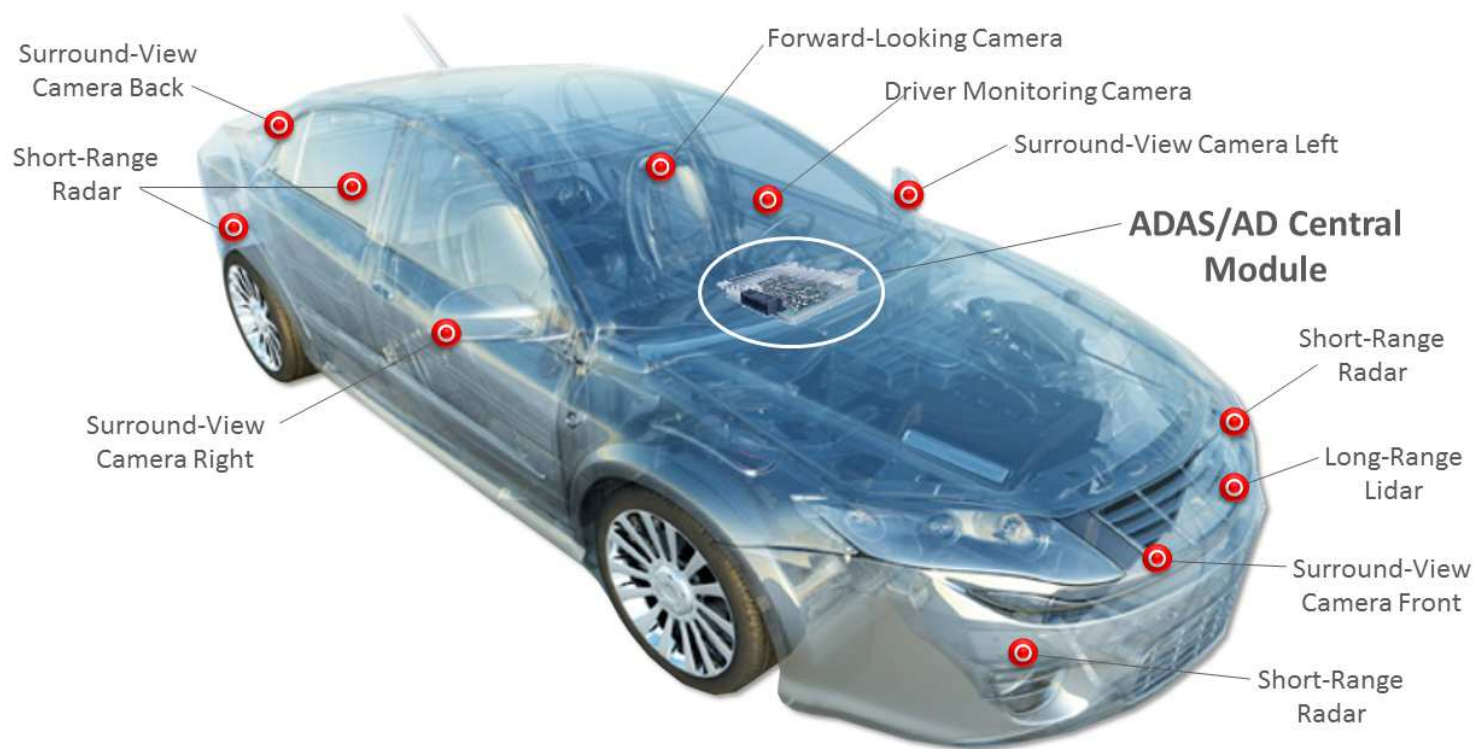
Source: IDC, Morgan Stanley Research

5G手機的複合成長率達37.9%



資料來源：DIGITIMES Research，2020/9

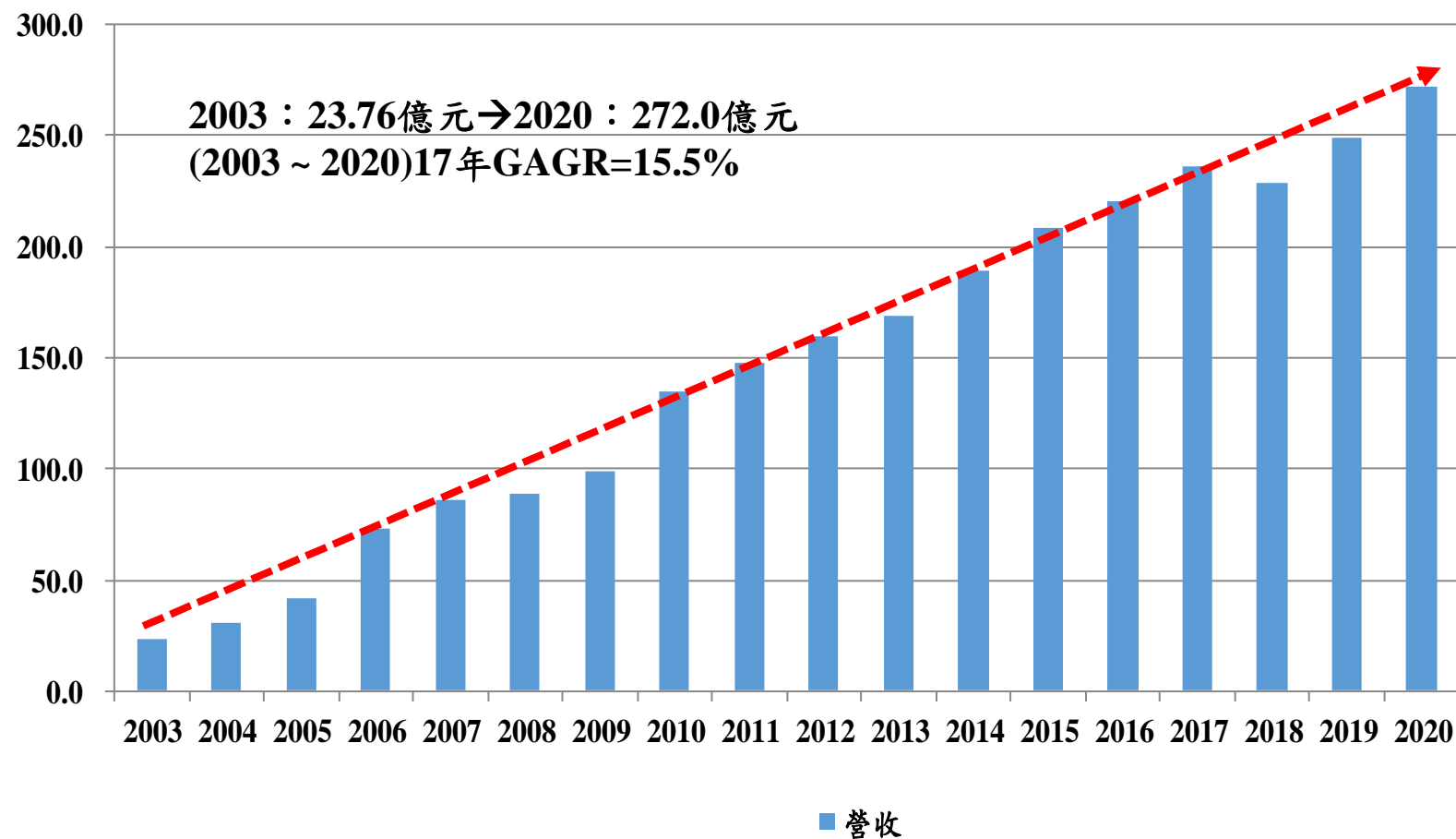
汽車電動化及智能化勢必採用高密度互連板



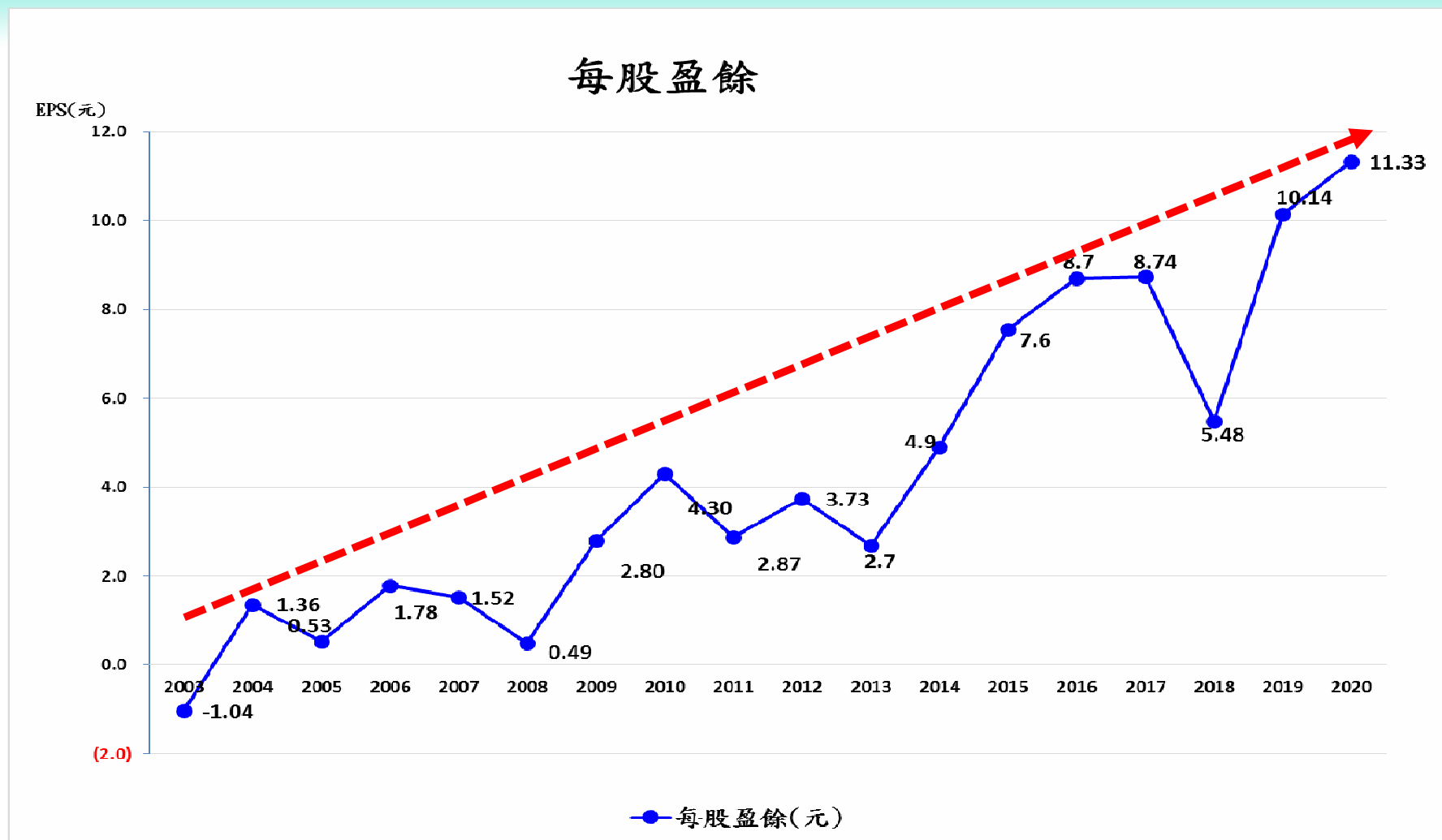
高密度互連板在汽車領域的應用在未來10年的滲透率可望大幅成長，特別是應用在高級駕駛輔助系統，車用資訊娛樂系統，及智慧車載系統。

營收成長趨勢

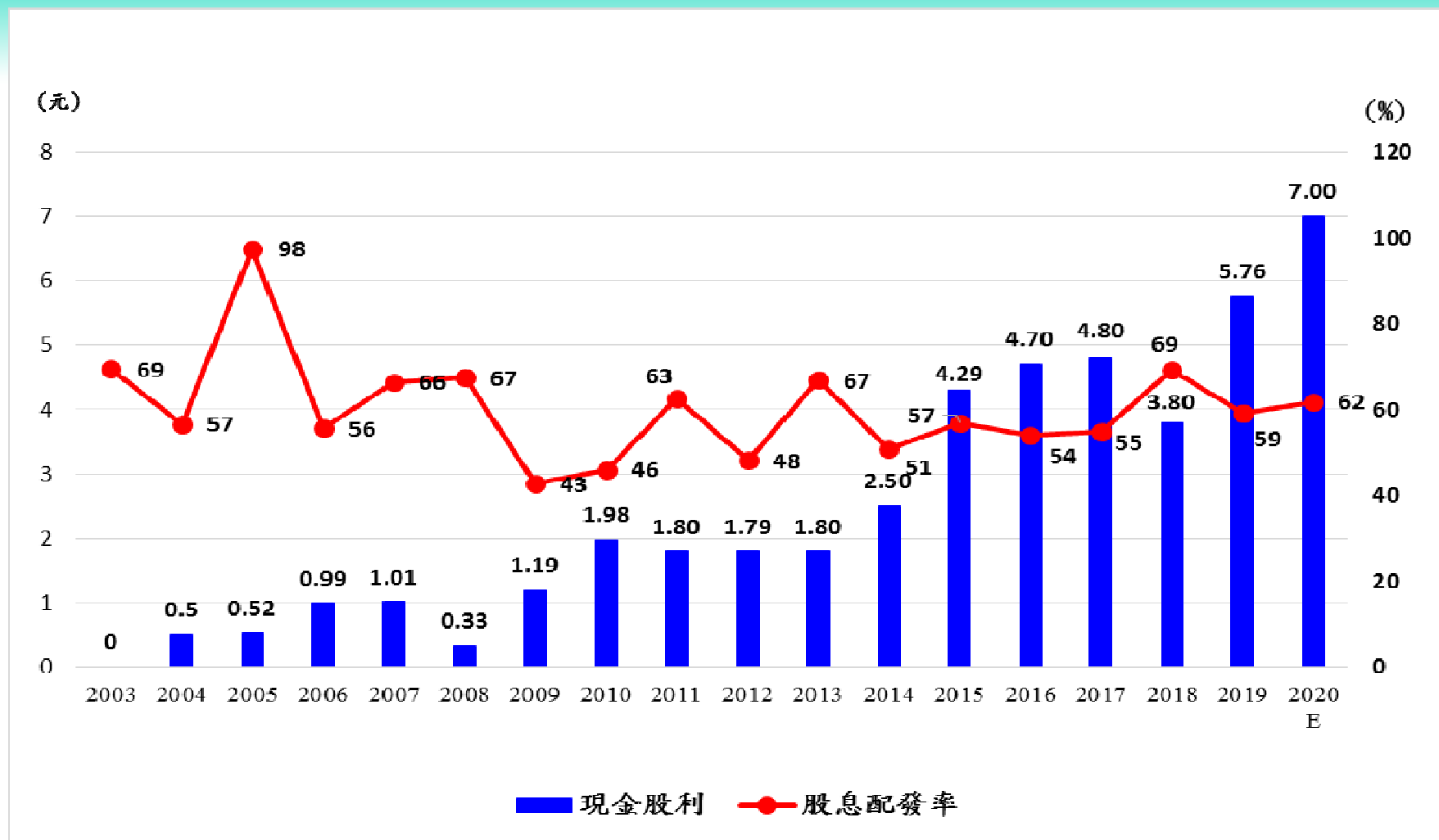
營收：新台幣億元



經營績效趨勢



每股現金股息暨股息配發率



損益表摘要

單位:新台幣百萬元

	4Q20	3Q20	QoQ	4Q19	YoY
營業收入	7,517	7,474	0.6%	6,780	10.9%
營業毛利	1,876	2,058	-8.8%	1,722	9.0%
營業利益	1,203	1,423	-15.5%	1,161	3.6%
繼續營業部門稅前淨利	1,287	1,438	-10.5%	1,182	8.9%
所得稅費用	(310)	(314)	-1.1%	(45) *	588.7%
稅後淨利	977	1,124	-13.1%	1,137	-14.1%
基本每股盈餘(新台幣元)	2.93	3.40	-13.8%	3.55 *	-17.5%
營業毛利率(%)	25.0%	27.5%		25.4%	
營業利益率(%)	16.0%	19.0%		17.1%	
稅後淨利率(%)	13.0%	15.0%		16.8%	

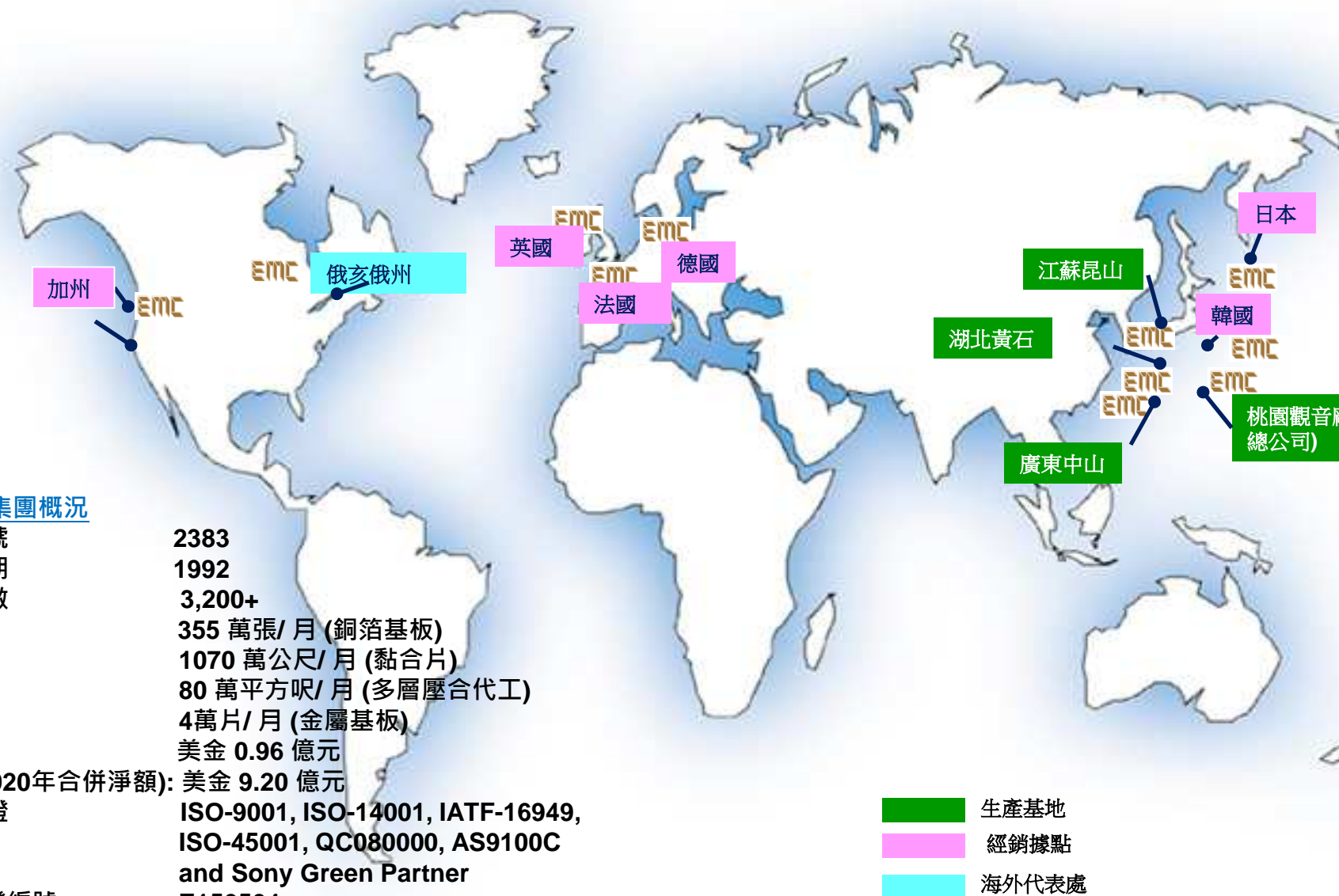
*附註: 若不計入第四季認列一次性所得稅利益2.23億元, 稅後每股盈餘為2.85元, YOY+2.8%.

資產負債表摘要

單位:新台幣百萬元	4Q20		3Q20		4Q19	
	金額	百分比	金額	百分比	金額	百分比
現金及約當現金	5,732	20.6%	5,328	20.2%	6,351	24.7%
應收帳款+應收票據	9,934	35.7%	9,571	36.2%	9,192	35.8%
存貨	3,702	13.3%	3,914	14.8%	2,905	11.3%
不動產、廠房及設備	6,531	23.4%	6,016	22.8%	5,858	22.8%
資產總計	27,857	100.0%	26,406	100.0%	25,704	100.0%
短期借款	1,162	4.2%	1,209	4.6%	1,100	4.3%
應付帳款	5,847	21.0%	6,114	23.2%	5,672	22.1%
長期借款	564	2.0%	545	2.1%	643	2.5%
業主權益	16,756	60.1%	15,533	58.8%	13,537	52.7%
負債及權益	27,857	100.0%	26,406	100.0%	25,704	100.0%

附註

公司簡介-全球生產基地及主要據點



■ 台光集團概況

股票代號	2383
成立日期	1992
員工人數	3,200+
月產能:	355 萬張/ 月 (銅箔基板) 1070 萬公尺/ 月 (黏合片) 80 萬平方呎/ 月 (多層壓合代工) 4萬片/ 月 (金屬基板)
資本額	美金 0.96 億元
營收 (2020年合併淨額):	美金 9.20 億元
資格認證	ISO-9001, ISO-14001, IATF-16949, ISO-45001, QC080000, AS9100C and Sony Green Partner
UL 認證編號	E150504

生產基地及月產能

